

ニュースガイドNo, 11126

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載！

貴金属メッキ方法と工程

[登録・公開編]平成28年(1年間) 100点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥25,920-	¥24,000-
全文紙収録 B5製本版	¥25,920-	¥24,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥38,880-	¥36,000-

既刊関連セットのご案内

No.	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,11045	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.27	70点	¥20,000
No,11021	"	"	平.26	68点	¥20,000
No,10875	"	"	平.25	67点	¥20,000
No,10817	"	"	平.24	69点	¥20,000
No,10702	"	"	平.23	69点	¥20,000
No,10567	"	"	平.22	70点	¥24,000
No,10429	"	"	平.21	72点	¥24,000
No,10293	"	"	平.20	78点	¥25,800
No,10157	"	"	平.19	88点	¥27,500
No,10047	"	"	平.18	89点	¥27,700
No,9920	"	"	平.17	84点	¥25,800
No,9787	"	"	平.16	87点	¥23,400
No,11002	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.26	70点	¥20,000
No,10891	"	"	平.25	70点	¥20,000
No,10830	"	"	平.24	70点	¥20,000
No,10700	"	"	平.23	59点	¥18,000
No,10579	"	"	平.22	59点	¥18,000
No,10493B	"	"	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20	60点	¥18,000

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
	合計 ¥	
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

貴金属メッキ方法と工程

No.11126

[登録・公開編]

平成28年(1年間)

100点

CD-ROM版 ¥25,920

B5製本版 ¥25,920 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥38,880)

- | | | | |
|--|--|---|---------------------|
| 1 金化合物の新規製造方法 | 小島化学薬品株式会社 | 28 真空チャンバー構成部品 | 太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社 |
| 2 銀めっき材 | DOWAメタルテック株式会社 | 電子部品用金属材料及びその製造方法、それを用いたコネクタ端子、コネクタ及び電子部品 | JX金属株式会社 |
| 3 銀めっき材 | DOWAメタルテック株式会社 | 30 樹脂/銅めっき積層体およびその製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 4 メソポーラス金属膜の製造方法 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 31 無電解白金めっき液、その製造方法、及び白金皮膜の形成方法 | メタローテクノロジーズジャパン株式会社 |
| 5 電気接点部品用金属材料 | 古河電気工業株式会社 | 32 電子部品用金属材料及びその製造方法、それを用いたコネクタ端子、コネクタ及び電子部品 | JX金属株式会社 |
| 6 ニッケル上に銀ストライクを電気めっきする方法 | ローム アンド ハース エレクトロニック マテリアルズエルエルシー | 33 圧入型端子及びそれを用いた電子部品 | JX金属株式会社 |
| 7 シアン化物を含まない銀電気めっき液 | ローム アンド ハース エレクトロニック マテリアルズエルエルシー | 34 還元型無電解金めっき液及び当該めっき液を用いた無電解金めっき方法 | 小島化学薬品株式会社 |
| 8 自己潤滑性コーティングおよび自己潤滑性コーティングの生産方法 | ティーイー コネクティブイジャーマニー ゲゼルシャフト ミット ベシュレン... | 35 メソポーラス金属膜 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
| 9 細線回路の製造方法 | アトテック・ドイチユラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシユレンクテル・ハフツング | 36 通信用クラッドワイヤおよびコード | ジャパンファインスチール株式会社 |
| 10 金化合物の新規製造法 | 小島化学薬品株式会社 | 半導体装置、積層型半導体装置、封止後積層型半導体装置、及びこれらの製造方法 | 信越化学工業株式会社 |
| 11 金属材料のめっき方法および固体高分子電解質膜・触媒金属複合電極の製造方法 | 三菱電機株式会社 | 38 半導体装置、積層型半導体装置、封止後積層型半導体装置、及びこれらの製造方法 | 信越化学工業株式会社 |
| 12 長尺導電性基板の電気めっき方法およびこの方法を用いた銅被覆長尺導電性基板の製造方法並びに... | 住友金属鉱山株式会社 | 39 ノンシアン金化合物の新規製造方法 | 小島化学薬品株式会社 |
| 13 2重金めっき方法及び電子部品 | 日栄技研株式会社 | 40 ノンシアン金化合物の新規製造法 | 小島化学薬品株式会社 |
| 14 被覆物および方法 | エクスタリック コーポレイション | 41 めっき装飾品、筆記具及びめっき装飾品の製造方法 | 名古屋メッキ工業株式会社 |
| 15 めっき積層体の製造方法及びめっき積層体 | オリエンタル鍍金株式会社 | 42 電子部品用金属材料及びその製造方法、それを用いたコネクタ端子、コネクタ及び電子部品 | JX金属株式会社 |
| 16 コネクタの製造方法及び銀のめっき方法 | 株式会社フジクラ | 43 耐フレッチング性及び耐ウイスキー性の被覆装置及び方法 | オリン コーポレイション |
| 17 電磁波シールド用金属箔及び電磁波シールド材 | JX金属株式会社 | 44 銀硫化防止材、銀硫化防止膜の形成方法及び発光装置の製造方法 | 日立化成株式会社 |
| 18 電磁波シールド用金属箔及び電磁波シールド材 | JX金属株式会社 | 45 Agめっき電極部材の製造方法 | 株式会社神戸製鋼所 |
| 19 電磁波シールド用金属箔、電磁波シールド材、及びシールドケーブル | JX金属株式会社 | 46 シアン系電解金めっき浴及びこれを用いるパンプ形成方法 | メタローテクノロジーズジャパン株式会社 |
| 20 メタライゼーション処理、混合物、および、電子デバイス | ラム リサーチ コーポレーション | 47 電気素子 | 矢崎総業株式会社 |
| 21 連続メッキ用バタニングロールの製造方法 | 株式会社シンク・ラボラトリー | 48 被コーティング物品およびそのコーティング方法 | エクスタリック コーポレイション |
| 22 チップ電子部品の製造方法 | サムソン エレクトロ・メカニクス カンパニーリミテッド. | 49 表面処理金属材料、キャリア付金属箔、コネクタ、端子、積層体、シールドテープ、シールド材、プリント配... | JX金属株式会社 |
| 23 有機金化合物結晶の新規製造方法 | 小島化学薬品株式会社 | 50 金属基材の表面に複数のAg-Sn合金層を有する導電材およびその製造方法 | 国立大学法人岩手大学 |
| 24 金レジネートの新規製造法 | 小島化学薬品株式会社 | 51 金めっき用ノンシアン金化合物の製造方法 | 小島化学薬品株式会社 |
| 25 非導電性基板の直接金属化方法 | エンソン インコーポレイテッド | 52 ノンシアン金化合物 | 小島化学薬品株式会社 |
| 26 フレッチング摩耗破片誘発抵抗率増大を起こしにくい部品を製造する方法 | オリン コーポレイション | 53 端子用部材およびその製造方法ならびにコネクタ用端子 | 株式会社オートネットワーク技術研究所 |
| 27 電子部品用金属材料 | JX金属株式会社 | | 以下47点省略 |